

- 반도체 후공정 소부장산업 경쟁력 강화사업 -

반도체 후공정산업 기술사업화 강화 지원 참여기업 모집공고

인천광역시와 인천테크노파크는 인천 수출 1위 품목인 반도체 후공정산업 분야 중소기업의 글로벌 사업화 경쟁력 강화를 위해 아래와 같이 기술(제품)의 사업화 강화에 필요한 시험평가·인증·지식재산권 확보·국내외 전시회 참가·정부 R&D 참여를 지원하고자 합니다. 참여를 희망하는 인천 내 중소·중견기업은 관련 규정과 절차에 따라 신청하여 주시기 바랍니다.

2025년 4월 21일

인천테크노파크 원장

[주 요 내 용]

- 사 업 명 : 반도체 후공정 소부장기업 기술사업화 강화 지원
- 지원기간 : 공고일 ~ 2025년 12월 31일(사업비 소진시까지)
 - ※ 신청서 접수, 접수 순위에 따라 우선 지원
- 지원대상 : 반도체 후공정(패키징) 분야 소재·부품·장비 관련 기업으로, 본사 또는 공장이 인천 내 소재하고 있는 중소·중견기업
- 지원규모 : 기업당 최대 10,000천원 이내 지원(민간 현금부담금 : 20% 이상)
- 지원내용 : 기술(제품)에 대한 시험(성능)평가, 인증획득, 특허출원(등록), 기술이전 수수료, 국내외 전시회 참가 비용, 정부 연구개발 참여 기업의 현금부담금 지원
 - ※ '25. 3. ~ '25. 12., 기간 내 시험(성능)평가·인증획득·특허 출원(등록)·국내외 전시회 참가를 완료하는 건에 한함

① 사업개요

- 지원명 : 반도체 후공정 소부장기업 기술사업화 강화 지원
- 사업목적 : 인천 소재 반도체 후공정(패키징) 분야 중소·중견기업의 글로벌 기술 주도과 시장 선점을 지원함으로써 산업 경쟁력을 강화하고자 함
- 지원기간 : 공고일 ~ 2025년 12월 31일(사업비 소진시까지)

② 지원내용

- 지원대상
 - 반도체 후공정(패키징) 분야 소재·부품·장비 관련 기업으로서, 본사 또는 공장이 인천 내 소재하고 있는 중소·중견기업
 - 정부 연구개발 지원사업에 ‘선정’ 결과를 통보받은 기업
 - 2025년 3월 ~ 2025년 12월 중 시험(성능)평가·인증획득·특허 출원(등록)·국내외 전시회 참가·기술이전을 완료하는 건에 한함
 - 전년도 해당사업으로 지원받은 기업 중 동일 항목으로 중복지원 불가
 - ※ '24년도 전시회 참가 지원받은 기업은 '26년도에 전시회 참가 지원 가능
 - ※ '24년도 전시회 참가 지원받은 기업은 '25년도에 전시회 참가를 제외한 다른 지원분야 지원 가능
 - 접수기한 마감일까지 인천반도체포럼에 회원가입이 된 기업
- 지원분야 : 반도체 후공정 관련 소재·부품·장비 관련 분야
- 지원내용
 - 반도체 후공정(패키징) 소부장기업의 정부 연구개발 기업부담금 지원
 - 소재·부품·장비 관련 검증을 위한 시험(성능)평가 비용
 - 소재·부품·장비에 대한 기술 현지화(국제 표준)를 위한 관련 인증 등
 - 국내외 전시회 참가비 지원(국내외 홍보, 마케팅)
 - 참가비, 홍보부스 설치, 홍보물 제작, 통/번역료 등 소요 비용(출장 경비는 제외)
 - 지적재산권 확보 비용 지원
 - 특허 출원·등록료, 기술이전 수수료
 - ※ 사사표기 문구 : 본 특허는 '2025년 반도체 후공정 소부장기업 혁신역량 강화 사업' 지원에 의한 결과물입니다.

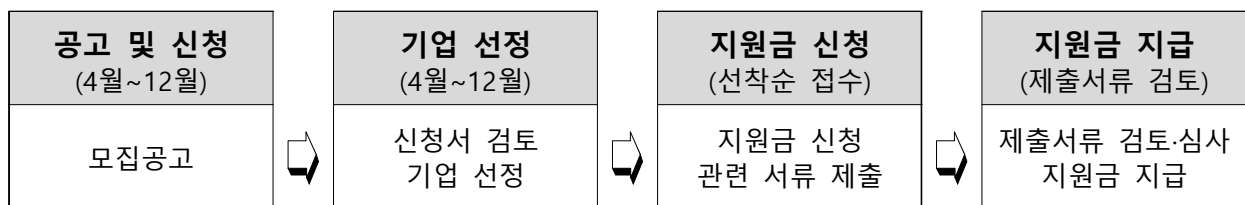
- 지원예산 : 기업당 최대 10,000천원 이내, 자부담 매칭 20%(현금) 이상
※ 부가세 기업 부담

③ 제출서류 및 신청방법

- 신청기간 : 공고일로부터 ~ 2025년 12월 17일(사업비 소진시까지)
- 신청방법 :
 - 인천 R&D관리시스템 IRDS (<https://irds.itp.or.kr>) 제출
- 제출서류

구분	서 식 명	파일형태	필수여부	
			필수	해당시
①	참여기업 신청서	HWP 및 PDF	○	
②	사업자등록증 및 법인등기부등본	PDF	○	
③	개인정보 처리동의서	PDF	○	

■ 추진절차



④ 지원금 지급 범위 및 제출서류 안내

- 지원금 신청 프로세스
 - ① 신청기업의 2025년도 기술(제품)인증획득/시험(성능)평가/특허출원(등록)/국내외 전시회 참가/기술이전 완료
 - ② 지원금 신청 서류 제출(e-mail, 우편 또는 방문제출)
 - E-mail 제출 : i-chip@itp.or.kr
 - ③ 지원금 지급 ※ 제출서류 미비 시 지원금 지급 불가
- 지원금 신청 제출서류

지원항목	제출서류	
정부 연구개발 기업부담금	<ul style="list-style-type: none"> ○ 협약서 1부. ○ 최종 사업계획서 또는 기업부담금을 확인할 수 있는 문서 1부. 	
시험평가 (성능확인 등)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시험접수 의뢰서 사본 1부. ○ 시험성적서 사본 1부. ○ 시험수수료 납부 영수증 1부. ○ 청구서(거래명세서) 1부. ※ 평가계획 검토수수료, 현장평가 수수료 포함 	
인증 (신기술인증, 기술검증, 표준화인증 등)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인증(검증)신청서 사본 1부. ○ 인증서(또는 기술검증서) 사본 1부. ○ 평가등록비 납부 영수증 1부. ○ 청구서(거래명세서) 1부. ※ 평가등록비용, 현장평가 수수료 포함 	
특허출원(등록)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 특허출원(등록)증 사본 1부. ○ 특허출원(등록)비 납부 영수증 1부. ○ 청구서(거래명세서) 1부. 	
국내외 전시회 참가	공통사항 ※필수제출	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지원금 신청서 1부 ○ 전시회 부스배치도 또는 디렉토리북 1부
	부스임차료 100% ※필수제출	<ul style="list-style-type: none"> ○ 임차료 인보이스(주최사 발행, 단가/부스면적 등 기재) ○ 임차료 송금영수증(외환거래계산서) 및 전문(remittance detail) ※ 카드결제 시 카드 명세서 혹은 내역서(외화금액, 환율기재) ※ 보험료, 등록료, 부가세, 해외 송금수수료 포함
	부스장치비 100%	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장치비 인보이스(주최사 발행, 비품별 단가, 수량 등 기재) ○ 장치비 송금영수증(외환거래계산서) 및 전문(remittance detail) ※ 카드결제 시 카드 명세서 혹은 내역서 (외화금액, 환율기재) ※ 보험료, 등록료, 부가세, 해외 송금수수료 포함
	홍보물제작비 100%	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제작비 인보이스(제작사 발행, 비품별 단가, 수량 등 기재) ○ 제작비 송금영수증(외환거래계산서) 및 전문(remittance detail) ※ 카드결제 시 카드 명세서 혹은 내역서 (외화금액, 환율기재) ※ 보험료, 등록료, 부가세, 해외 송금수수료 포함
	전시품 운송비 (편도, 1CBM 기준)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해상/항공 편도 운송비 인보이스(운송부피(CBM) 기재) ○ 운송비 송금영수증(간이영수증 불가) ※ 국내 입고장소에서 해외전시장까지의 운송비(편도) (해외에서 반입하는 운송비 지원 불가)
	통역비 50%	<ul style="list-style-type: none"> ○ 통역확인증 *통역원 자필 기재 및 서명 ○ 통역원 신분증 사본 첨부 ※ 1개사 당 1인, 전시기간 통역 ※ 전시회 개최일 외환은행 최초고시 매매기준율 및 코트라 통역단가 적용
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지원금 신청서 1부. ○ 회사명의 통장사본 1부. ○ 지방세·국세 납입 증명서 1부. ○ 사업자등록증 사본 1부. 	

※ 카드 결제 시 카드사 발급 명세서 제출

5 기타사항

○ 과제접수 및 수행 시 주의사항

- ① 제출된 서류는 일체 반환하지 않음
- ② 제출된 서류 및 과제계획서가 허위, 위·변조, 그 밖의 방법으로 부정하게 작성된 경우 관련 규정에 의거 선정 취소 및 협약 해약, 지원사업 참여 등을 제재할 수 있음
- ③ 과제 신청 관계자(기업, 대표자, 과제책임자 등)는 채무불이행 등 신용조회, 설문조사 및 과제 관리를 위한 개인정보 활용에 동의한 것으로 간주
- ④ 추가 증빙 서류를 별도로 요청할 수 있음
- ⑤ 과제선정 후 정당하지 아니한 사유로 수행 포기 시 참여제한 등 제재 가능

■ 문의(접수)처

○ 인천테크노파크 녹색반도체센터 박용준 책임연구원

- Tel. 032-260-0847 / E-mail. i-chip@itp.or.kr